



半导体行业月报：晶圆代工 产能增加 “元宇宙” 成行 业新宠



今年三季度全球晶圆代工厂产能增加明显，芯片产量增加，使得半导体市场保持高速增长，但是各行业缺芯现象仍然严重，新增产能还未能满足需求增长，预计到明年下半年全球缺芯现象才会得到缓解。

存储方面，PC 厂商的 DRAM 的库存水平上升，使得 DRAM 需求下降，10 月份 DRAM 价格下降 10%，随着 PC 以及服务器需求水平的下降，DRAM 价格还将持续下跌。相对来说 NANDFLASH 的价格比较平稳，但是整体销量增长有限。第四季度，全球存储芯片仍有降价预期。

下游市场，手机方面，除了苹果手机外，9 月其他品牌手机销量均有下降，手机作为存量市场，技术创新仍是主要竞争方向，iPhone13 在芯片、显示器等方面有着较高的技术优势，其市场份额短期内难以撼动。

汽车方面，传统燃油车仍受困于芯片不足，产销量下降，解决芯片问题的关键在于供应链本土化。

从全球范围来看，9 月英伟达、AMD 涨幅明显，主要得益于元宇宙概念，随着 Meta 持续在元宇宙布局，未来几个月“元宇宙”仍是市场的热点，不过目前元宇宙硬件方面发展还比较有限，VR、AR 的普及率较低，可以关注软件方面的技术突破。

晶圆代工方面，台积电回绝了美国的数据提供要求，这一定保住了台积电的信誉和议价权，但是此次事件表现出台积电等海外代工厂数据泄露的风险，未来大陆企业将会更偏向于本土制造，发展本土半导体产业链仍

是未来行业的重点，这将有利于大陆半导体企业的发展。

关注标的：景嘉微(300474)、士兰微(600460)、韦尔股份(603501)、北方华创(002371)、新洁能(605111)、立昂微(605358)、国科微(300672)、斯达半导(603290)。

风险提示

存储器库存逐渐饱和，存储芯片预期持续降价；居家办公需求下降将使下游市场增长乏力。

关键词: AR 芯片 苹果

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28777

